

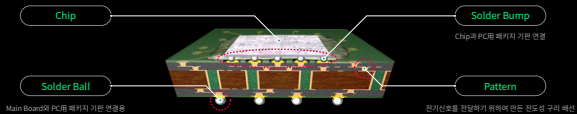
FCBGA (SC)

개요

OVERVIEW

반도체를 메인보드와 연결하기 위한 고집적 패키지 기판

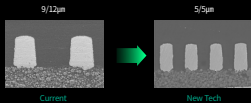
- 응용분야 : CPU, GPU, FPGA, AI 가속기 등



핵심 기술

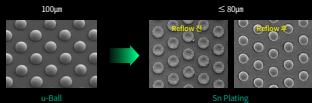
CORE TECHNOLOGY

미세 회로 개발



· 필요기술 : 차세대 노광 공법

미세 범프 개발



· 필요기술 : Sn Plating 공법

주요 사양

KEY SPECIFICATIONS

기판 층수	4~10층
Core 두께	400µm ↑
회로 (Line/Space)	9/12µm
Bump Pitch	100µm

※ SC: Standard Core